

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

上海合晶硅材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
会议主题	上海合晶公司近况交流会
参与单位名称	中新创融、万向创投、太平洋自营、信达资本、中信证券、永赢基金、半夏投资
时间	2025年12月24日
地点	上海
上市公司接待人员姓名	执行董事、总经理 陈建纲 董事会秘书 庄子祯 财务总监 方时彬 IR 黄倩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资机构参访上海晶盟硅材料有限公司工艺流程，公司领导对近况进行简单介绍，并就投资者关心的问题回答。</p> <p>问题 1：公司如何看待 CIS 的市场前景，相关的产品策略是什么？</p> <p>答复：随着 AI 发展，场景化应用极大带动了模拟芯片（主要是 CIS）市场增长。智能驾驶、智能眼镜、人形机器人、无人机等领域对 CIS 的需求大幅增加，全球 CIS 市场规模将从目前约 200 亿美金快速增长到 300 多亿美金。国内中低端 CIS 市场已基本实现国产化替代，但是高端市场仍被</p>

索尼、安森美等企业占据，因此高端硅片国产替代空间大，公司正在进行高端突破。

公司利用在超低阻、极低阻、低压低功耗的差异化技术优势，和国内 CIS 大厂合作高端 CIS 项目，已立项开发低功耗、超低功耗智能载具与成像系统用的外延片，进行 CIS 高端国产化替代，目前已经量产。在 12 英寸领域，公司聚焦高端 CIS 产品。上海合晶是全世界最早一批进入 POWER 领域的，未来将借助 POWER 领域和国际大厂的合作经验加速导入高端 CIS 领域，应用于 5000 万像素的手机用 CIS 和车规级 CIS。

问题 2：上海合晶在高端国产化替代的背景下，公司如何规划 8 英寸和 12 英寸大硅片产品线？

答复：公司坚持“8 英寸成为标杆”，加速替代海外同业公司在国内的市场份额。同时，“12 英寸做强做大”，12 英寸先进工艺（14 纳米及以下）国产化替代率不到 10%，成熟工艺 50%多一点，整体国产化替代率在 50%左右。12 英寸硅片国内需求（正片）近 250 万片/月，还有 120-130 万片/月的国产替代空间，国产替代空间大。公司 12 英寸现有产能明年预计订单饱满，目前正在加速建设郑州合晶扩产项目以满足市场需求。

问题 3：公司目前以及未来的产品布局规划是什么？

答复：目前，上海合晶主要有三个厂，扬州合晶生产 6 英寸和 8 英寸的晶棒；上海晶盟生产 6 英寸、8 英寸、12 英寸外延片；郑州合晶负责 8 英寸、12 英寸的长晶、切磨、抛光以及 12 英寸模拟芯片 CIS 用的长晶、衬底、外延一体化。

公司短期目标是到明年底 12 英寸产能达到 10 万片/月。同时，公司正在进行 P/P-逻辑用外延片的研发送样，长期规划实现 10 万片/月 P/P-用外延片产能。

	<p>公司当前产能规划是：12 英寸外延片产能目前 4 万片/月，主要用在 POWER；预计郑州二期今年年底通线，2026 年底完成 6 万片/月 12 英寸外延片产能建制，主要用在 CIS，目前国内目标客户已锁定，完成送样阶段。</p> <p>和大多数国内同业不同，上海合晶采取分步建设策略。公司采用迭代发展的模式，从 4 英寸到 6 英寸、8 英寸再到 12 英寸，从 POWER 用到 CIS 用到 P/P-用，逐步扩大产能。这种分步建设的策略避免了重资本投入带来的风险，同时有利于经验的积累和技术的提升。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	